

附件一之 1

新北市高中職教師晶圓代工與先進封裝技術應用商機研習課程規劃

- 一、依據「新北市 AI+科技高中暨實驗班專案計畫辦理」。
- 二、研習日期：113 年 8 月 5 日、8 月 12 日、8 月 19 日。
- 三、研習地點：新北市立樟樹國際實中勤學樓四樓會議室。
- 四、報名對象：新北市 AI+科技高中暨實驗班專案計畫學校請薦派參加，其餘開放本市高中職教師參與。
- 五、本研習課程為系列研習，建議報名教師全數參加。
- 六、報名請至本市教師研習系統。

日期	時間	節數	主題	主講人	地點
第一場次 113/8/5	08:30-12:30	4	半導體基礎與材料科學	待聘 (內聘 1 小時 外聘 3 小時)	新北市立樟樹 國際實中
第二場次 113/8/12		4	晶元製造工藝入門	待聘 (內聘 1 小時 外聘 3 小時)	新北市立樟樹 國際實中
第三場次 113/8/19		4	晶元製造的進階工藝技術	待聘 (內聘 1 小時 外聘 3 小時)	新北市立樟樹 國際實中

附件一之 2

新北市高中職教師晶圓代工與先進封裝技術應用商機研習實施流程

研習時間：113 年 8 月 5 日

研習地點：樟樹國際實中 勤學樓四樓會議室

時間	活動內容	主講/負責人
08:00~08:20	報到	樟樹國際實中
08:20~08:30	開場	新北市教育局
08:30~09:20	半導體素養課程概論	陳浩然校長
09:20~09:30	休息	
09:30~10:20	晶元製造工藝概論	外聘講師
10:20~10:30	休息	
10:30~11:20	晶元封裝技術及其應用	外聘講師
11:20~11:30	茶敘	
11:30~12:20	先進封裝技術與未來發展	外聘講師
12:20~12:30	賦歸	